



TIA™ 600P系列产品大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上，这些胶带具有极强的粘合强度，并且热阻抗小，可以有效的取代滑脂和机械固定。

TIA™ 600P系列特性表		
颜色	白色	Visual
胶粘剂类型	压克力胶粘剂	*****
基材类型	PET	*****
使用温度范围	-45~120°C	*****
厚度范围	0.0050"-0.010"	ASTM D374
击穿电压	>1000 VAC	ASTM D149
热传导率	0.8 W/mK	ASTM D5470
180° 剥离强度	> 800 g/inch (Steel, Immediate)	PSTC-1
180° 剥离强度	>1000 g/inch (Steel after 24 hrs)	PSTC-1
保持力 25 °C/Hours	> 4 Hours	PSTC-7
保持力 80 °C/Hours	> 4 Hours	PSTC-7
防火等级	94 V0	UL E331100

特性

- 》导热率: 0.8 W/mK
- 》高性能热传导压克力胶
- 》高粘结强度各种表面的双面压敏胶带

应用

- 》使散热片固定于已封装之芯片上
- 》使散热器固定于电源供应器电路板或车用控制电路板上
- 》可替代热熔胶、螺丝、扣具等固定方式

产品规格

标准厚度:

TIA605P:0.005"(0.127mm)

TIA608P:0.008"(0.203mm)

TIA610P:0.010"(0.254mm)

如需不同厚度请与本公司联系。

标准尺寸:

40" x 100"(1016mm x 30.48M)TIA600P系列可模切成不同形状提供。

补强材料:

TIA™600P系列卷材可带聚对苯二甲酸乙二酯薄膜为补强。

导热材料

加拿大:
Tel:+001-604-2998559
E-mail: sales@thermazig.com

发热材料

导热工程塑料

中国:
Tel: +86-769-38801208
E-mail: frances@ziitek.com.tw

发泡硅胶

台湾:
Tel:+886-2-22771007
E-mail: frances@ziitek.com.tw

模切制品

导热介面材料
应用技术下载

